

## 杭州士兰微电子股份有限公司

### 关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

● **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次预计担保额度 (万元)	截至目前实际为其提供的担保余额 (万元)	是否在前 期预计额 度内	本次担保是否 有反担保
杭州士兰集昕微电子有 限公司（以下简称“士兰 集昕”）	290,000	73,437.00	不适用：本 次为 2026 年度日常担 保额度预 计，包含存 量日常担保	否
杭州士兰集成电路有 限公司（以下简称“士兰集 成”）		34,500.00		
杭州美卡乐光电有 限公司（以下简称“美卡乐”）		7,095.92		
成都士兰半导体制造有 限公司（以下简称“成都 士兰”）		30,361.98		
成都集佳科技有 限公司（以下简称“成都集佳”）		13,825.00		

● **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司 对外担保总额（万元）	524,815.20
对外担保总额占上市公司最近一期经 审计净资产的比例（%）	43.85

**一、担保情况概述**

（一）担保的基本情况

为满足 2026 年度杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“士兰微”或“本公司”）及全资子公司、控股子公司的发

度对资产负债率为 70%以下的主要全资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 290,000 万元。实际发生日常担保时，公司可以在上述预计的日常担保总额度内，对资产负债率为 70%以下的不同控股子公司（包含年中新增或新设的控股子公司）进行相互调剂。

（二）内部决策程序

2026 年 4 月 23 日，公司召开的第九届董事会第九次会议审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案》并同意将该议案提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	本次预计担保额度（万元）	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率未超过 70%									
士兰微	士兰集昕	直接持股 55.54%； 间接持股 44.43%	39.56	73,437.00	290,000 (注 1)	24.23	一年 (注 3)	否	否
士兰微	士兰集成	直接持股 99.17%	38.84	34,500.00					
士兰微	美卡乐	直接持股 43.00%； 间接持股 56.53%	43.64	7,095.92					
士兰微	成都士兰	直接持股 64.15%	19.06	30,361.98 (注 2)					
士兰微	成都集佳	间接持股 64.15%	50.37	13,825.00					
合计	/	/	/	159,219.90	290,000	24.23	/	/	/

注 1：以上担保预计金额包含以前年度延续至 2025 年度的日常担保余额，不包含已经独立审批的专项担保：公司为成都士兰 5 亿元项目贷款提供的担保，已经 2024 年 9 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

注 2：截至目前，公司对成都士兰日常融资事项实际提供的担保余额为 25,740.00 万元，公司为成都士兰 5 亿元项目贷款担保事项实际提供的担保余额为 4,621.98 万元，合计担保余额为 30,361.98 万元。

注 3：本次担保预计额度自 2025 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。如公司 2026 年年度股东会与 2025 年年度股东会间隔超过 12 个月的，在 2026 年年度股东会召开前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保依然有效。

## 二、被担保人基本情况

### （一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	杭州士兰集昕微电子有限公司	控股子公司	本公司直接持有 55.54% 杭州集华投资有限公司（以下简称“集华投资”）直接持有 41.24% 士兰集成直接持有 3.22% （本公司通过集华投资间接持有 41.24%，通过士兰集成间接持有 3.19%）	91330101MA27W6YC2A
法人	杭州士兰集成电路有限公司	控股子公司	本公司直接持有 99.17% 杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）直接持有 0.83%	913301017265863549
法人	杭州美卡乐光电有限公司	控股子公司	本公司直接持有 43.00% 士兰集成直接持有 57.00% （本公司通过士兰集成间接持有 56.53%）	91330101689094018G
法人	成都士兰半导体制造有限公司	控股子公司	本公司直接持有 64.15% 国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司直接持有 23.90% 成都市重大产业化项目一期股权投资基金有限公司直接持有 10.28% 成都天府水城鸿明投资有限公司直接持有 1.67%	91510121564470905W
法人	成都集佳科技有限公司	控股子公司	成都士兰直接持有 100% （本公司通过成都士兰间接持有 64.15%）	9151012134303590X1

### （二）主要财务指标

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
士兰集昕	340,171.02	134,586.72	205,584.30	152,740.97	-598.12	341,496.57	135,314.15	206,182.41	143,014.77	-5,447.17
士兰集成	190,186.90	73,860.95	116,325.95	182,294.25	20,169.80	168,247.80	72,091.65	96,156.15	154,144.61	14,196.43
美卡乐	35,919.19	15,676.44	20,242.74	22,533.82	-503.27	39,794.52	19,048.51	20,746.01	31,262.94	1,475.33
成都士兰（母公司报表口径）	353,861.56	67,429.71	286,431.86	110,247.50	-14,967.86	359,027.64	67,627.93	291,399.71	84,707.48	-9,722.14
成都集佳	216,578.35	109,082.87	107,495.48	195,931.10	21,776.08	158,502.94	72,783.55	85,719.40	140,022.76	17,564.80

注：上表尾差系四舍五入所致。

（三）士兰集昕、士兰集成、美卡乐、成都士兰和成都集佳均为本公司的全资子公司或控股子公司（孙公司），均未被列为失信被执行人，均不存在影响偿债能力的重大或有事项。

### 三、担保协议的主要内容

本次年度日常担保预计事项尚未经公司股东会审议，除已根据相关董事会、股东会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订具体担保协议。公司股东会审议通过后，本公司将根据上述公司的申请，根据实际资金需求予以安排。

#### 四、担保的必要性和合理性

公司本次担保事项是为了满足上述控股子公司日常生产经营的资金需求，有利于公司主营业务的发展；被担保人生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。

被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，能够有效监控其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可控范围内；被担保人士兰集昕的其他股东为集华投资和士兰集成，被担保人美卡乐的其他股东为士兰集成，均为本公司之控股子公司；被担保人士兰集成的其他股东为友旺电子，其持股比例较小且不参与士兰集成的日常经营；被担保人成都集佳为被担保人成都士兰的全资子公司，成都士兰的其他股东主要系财务投资和产业扶持的专业产业投资基金，持股比例较小，且不参与其日常经营。故被担保人的其他股东暂无明显提供担保的必要性，其未提供同比例担保，不违背公平、对等原则。

本次担保事项符合相关法律法规、上海证券交易所自律规则及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### 五、董事会意见

公司于 2026 年 4 月 23 日召开的第九届董事会第九次会议以 15 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案》并同意将该议案提交股东会审议。在股东会批准上述担保事项的前提下，公司同时提请股东会授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关法律文件。

#### 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 52.482 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 43.85%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 35.40%；公司为厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 10.108 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 8.45%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（担保总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年4月25日